유진투자증권

IPO 예정 | IT 소부장 산업 | 2024.09.30

에이치엔에스하이텍
(044990,KQ)

글로벌 3위의 ACF 전문 제조업체

상장 예정일
2024.10.중순

기관 수요예측
2024.09.30 ~ 10.08

공모희망가 밴드
22,000 ~ 26,000 원

예상 시가총액
176.8 ~ 208.9(십억원)

코스닥벤처팀 박종선_ jongsun.park@eugenefn.com

- 1995년 ㈜디에스아이 설립, 2000년 텔레포스㈜로 사명 변경. 2009년 에이치엔에스하이텍(H&S HighTec)로 사명 변경. 2015년 12월에 코넥스 시장에 상장. 10월 중으로 코스닥 시장으로 이전상장 예정임. 동사는 설립 초기부터 ACF (Anisotropic Conductive Film, 이방성 전도 필름. 디스플레이 패널과 카메라 모듈 등의 회로기판 연결에 사용. 접착 및 도전 재료 핵심 소재)사업을 시작하였으며, 2012년 ㈜이그젝스 ACF사업부 인수, 2012년 LG이노텍㈜ ACF 사업부를 인수하면서 사업을 강화, 글로벌 3위, 국내 1위 시장지배력 확보함. 또한, 2012년에 케이큐브㈜를 흡수합병하면서 수정진동자 및 발진기 사업의 전자사업부를 통해 사업을 확대함.
- 매출 비중(2023년 기준)은 소재 제품(ACF 등) 72.5%, 전자 제품(수정진동자 등) 3.9%, 기타 상품 23.6%
- 투자포인트-1: 시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장 지속 전망. ① 초균일 기술로 도전볼의 약 60%를 감소시킬 수 있는 차별화된 제품 경쟁력을 확보한 가운데, ② 글로벌 기업의 경쟁업체의 구조조정으로 인하여 현재 글로벌 3위(일본의 Dexerials, 레조낙과 경쟁), 국내 1위의 시장지배력을 확보함.
- 투자포인트-2: 신규 사업을 통한 중장기 실적 성장 기대. ① OCR(Optically Clear Resin)/OCA(Optically Clear Adhesive) 필름의 시장 진입 초기. ② Micro LED 내 칩과 기판의 접합 제품을 개발, 상용화 예정임.
- 공모희망가(밴드: 22,000 ~ 26,000원)는 최근 반기 연환산 기준으로 국내 유사기업의 평균 PER 19.9배를 적용하여 산출한 주당 평가가액 32,247원 대비 19.4 ~ 31.8% 할인하여 산정함(증권신고서 기준)
- 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 68.4%(549만주, 1,428억원[상단 기준])로 부담스러운 수준임.

액면가	500원
자본금(십억원)	
공모/ 공모후	3.8 / 4.0
공모후 주식수	8,036,064주
유통가능주식수	5,494,051주
보호예수기간	
최대주주 등	1년
5% 이상 주주	1 ~ 3개월
기타주주	6개월
상장주선인	6개월
주관증권사	미래에셋증권
공모 후 주요주주(%)	
최대주주 등	18.4
5% 이상 주주	12.4
기타주주	62.7
상장주선인	0.3
공모주주(일반+기관)	6.2

12 월 결산(십억원)	2021A	2022A	2023A	2024E
매출액	87.3	97.2	80.6	86.0
영업이익	10.1	21.6	14.0	16.0
세전손익	11.3	21.4	34.3	15.9
당기순이익	10.3	19.3	30.1	13.1
지배당기순이익	10.3	19.3	30.1	13.1
EPS(원)	-	-	-	1,630
증감률(%)	-	-	-	-
PER(배)	-	-	-	13.5 ~ 16.0

자료: 유진투자증권

동사의 주요 고객



I. 공모 개요 및 보호 예수 현황

도표 1. **공모 개요 및 일정**

희망 공모가	22,000 ~ 26,000 원	수요예측일	2024.09.30 ~ 10.08
공모 금액	110 ~ 130 억원	공모청약일	2024.10.14 ~ 15
공모 주식수	500,000 주	납입일	2024.10.17
상장 후 주식수	8,036,064 주	환급일	2024.10.17
예상 시가총액	1,768 ~ 2,089 억원	상장 예정일	2024.10 월 중

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 2. **공모 후 주주 구성**

주주명	주식수(주)	비중 (%)
최대주주 등	1,480,172	18.42
5% 이상 주주	995,425	12.39
기타주주	5,035,467	62.66
상장주선인	25,000	0.31
공모주주(일반+기관)	500,000	6.22
합계	**8,036,064**	**100.0**

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 3. **보호예수 및 예탁 현황**

주주명	주식수(주)	비중 (%)	보호예수기간
최대주주 등	1,480,172	18.42	1 년
5% 이상 주주	663,617	8.26	1 ~ 3 개월
기타주주	373,224	4.64	6 개월
상장주선인	25,000	0.31	6 개월
-	-	-	-
합계	**2,542,013**	**31.63**	

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 4. **유통가능 주식수**

주주명	주식수(주)	비중 (%)
5% 이상 주주	331,808	4.13
기타주주	4,662,243	58.02
공모주주(일반+기관)	500,000	6.22
-	-	-
합계	**5,494,051**	**68.37**

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 5. **공모그룹별 배정 내역**

그룹	주식수	비중 (%)
기관투자자등	350,000 ~ 375,000	70.0 ~ 75.0
일반청약자	125,000 ~ 150,000	25.0 ~ 30.0
우리사주조합	-	-
합계	**500,000**	**100.0**

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 6. **자금의 사용목적** **(단위: 백만원)**

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권 취득자금	기타	계
8,500	-	-	-	-	2,150	10,650

자료: 증권신고서, 유진투자증권

도표 7. **상장 후 유통제한 및 유통가능 물량 세부내역**

구분	성 명	관 계	주식의 종류	공모 후						의무 보유 기간	의무 보유 사유
				보유주식		매각제한 물량		유통가능 물량			
				주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율		
최대주주 등	김정희	최대주주	보통주	1,353,689	16.85%	1,353,689	16.85%	-	0.00%	1 년	주 1)
	김예진	친족	보통주	13,635	0.17%	13,635	0.17%	-	0.00%	1 년	주 1)
	김서준	친족	보통주	13,635	0.17%	13,635	0.17%	-	0.00%	1 년	주 1)
	이영원	친족	보통주	1,040	0.01%	1,040	0.01%	-	0.00%	1 년	주 1)
	조명준	임원	보통주	50,015	0.62%	50,015	0.62%	-	0.00%	1 년	주 1)
	배의호	임원	보통주	24,044	0.30%	24,044	0.30%	-	0.00%	1 년	주 1)
	금창원	임원	보통주	10,911	0.14%	10,911	0.14%	-	0.00%	1 년	주 1)
	김종철	임원	보통주	2,000	0.02%	2,000	0.02%	-	0.00%	1 년	주 1)
	성상우	임원	보통주	1,040	0.01%	1,040	0.01%	-	0.00%	1 년	주 1)
	김준범	임원	보통주	693	0.01%	693	0.01%	-	0.00%	1 년	주 1)
	고동철	임원	보통주	1,010	0.01%	1,010	0.01%	-	0.00%	1 년	주 1)
	장복수	임원	보통주	31	0.00%	31	0.00%	-	0.00%	1 년	주 1)
	에이치엔에스하이텍㈜	자기주식	보통주	8,429	0.10%	8,429	0.10%	-	0.00%	1 년	주 1)
	소 계			**1,480,172**	**18.42%**	**1,480,172**	**18.42%**	**-**	**0.00%**	-	-
5% 이상 주주	한국투자파트너스㈜	벤처금융	보통주	541,371	6.74%	-	0.00%	180,457	2.25%	-	-
			보통주			180,457	2.25%	-	0.00%	1 개월	주 2)
			보통주			180,457	2.25%	-	0.00%	3 개월	주 2)
	아주아이비투자㈜	벤처금융	보통주	454,054	5.65%	-	0.00%	151,351	1.88%	-	-
			보통주			151,351	1.88%	-	0.00%	1 개월	주 2)
			보통주			151,352	1.88%	-	0.00%	3 개월	주 2)
	소계			**995,425**	**12.39%**	**663,617**	**8.26%**	**331,808**	**4.13%**	-	-
기타 주주	임 OO 등 3 인	-	보통주	373,224	4.64%	373,224	4.64%	-	0.00%	6 개월	주 2)
	기존 주주	-	보통주	4,662,243	58.02%	-	0.00%	4,662,243	58.02%	-	-
	소계			**5,035,467**	**62.66%**	**373,224**	**4.64%**	**4,662,243**	**58.02%**	-	-
공모 주주	기관투자자, 일반청약자	-	보통주	500,000	6.22%	-	0.00%	500,000	6.22%	-	-
의무 인수	미래에셋증권㈜	상장주선인	보통주	25,000	0.31%	25,000	0.31%	-	0.00%	6 개월	주 3)
합계				**8,036,064**	**100.00%**	**2,542,013**	**31.63%**	**5,494,051**	**68.37%**	-	-

주 1) 코스닥시장 상장규정 제 26 조제 1 항제 1 호에 의거 상장일로부터 1 년 간 보호예수됩니다.
주 2) 코스닥시장 상장규정 제 26 조제 1 항제 7 호에 의거 상장일로부터 1 개월, 3 개월 및 6 개월 간 보호예수됩니다.
주 3) 코스닥시장 상장규정 제 13 조제 5 항제 1 호제가목에 의거 상장일로부터 6 개월 간 보호예수됩니다.
자료: 증권신고서, 유진투자증권

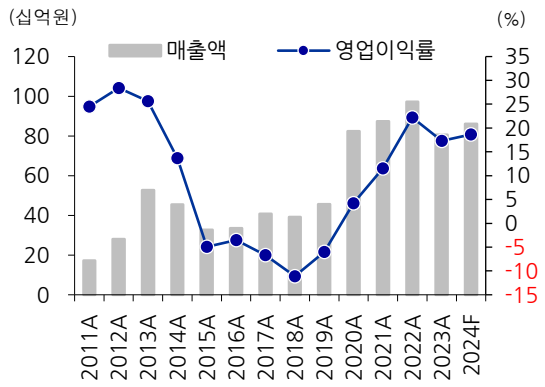
Ⅱ. 실적 추이 및 전망

도표 8. **연간 실적 추이 및 전망 (연결 기준)**

(십억원,%)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022A	2023A	2024F
매출액	**52.7**	**45.5**	**32.7**	**33.5**	**40.7**	**39.1**	**45.6**	**82.4**	**87.3**	**97.2**	**80.6**	**86.0**
증가율(%,yoy)	*88.2*	*-13.7*	*-28.1*	*2.5*	*21.3*	*-3.9*	*16.7*	*80.6*	*6.0*	*11.3*	*-17.1*	*6.8*
사업별 매출액(십												
소재 제품	-	-	-	-	-	-	-	-	47.2	60.1	58.4	67.7
전자 제품	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	6.0	3.1	3.4
기타 상품	-	-	-	-	-	-	-	-	36.3	31.1	19.0	15.0
사업별 비중(%)												
소재 제품	-	-	-	-	-	-	-	-	54.1	61.8	72.5	78.7
전자 제품	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	6.2	3.9	3.9
기타 상품	-	-	-	-	-	-	-	-	41.6	32.0	23.6	17.4
수익												
매출원가	27.5	25.6	21.9	23.1	30.1	30.3	35.3	64.8	62.6	57.6	45.3	46.7
매출총이익	25.2	19.9	10.9	10.5	10.6	8.9	10.4	17.6	24.7	39.6	35.3	39.3
판매관리비	11.7	13.7	12.5	11.7	13.3	13.2	13.1	14.2	14.7	18.0	21.3	23.3
영업이익	**13.5**	**6.2**	**-1.6**	**-1.2**	**-2.7**	**-4.3**	**-2.7**	**3.5**	**10.1**	**21.6**	**14.0**	**16.0**
세전이익	**10.6**	**4.0**	**-1.8**	**-0.7**	**-3.9**	**-4.3**	**-3.0**	**2.5**	**11.3**	**21.4**	**34.3**	**15.9**
당기순이익	**10.8**	**3.6**	**-0.9**	**-0.2**	**-3.7**	**-4.0**	**-2.8**	**1.5**	**10.3**	**19.3**	**30.1**	**13.1**
지배당기순이익	**10.8**	**3.6**	**-0.9**	**-0.2**	**-3.7**	**-4.0**	**-2.8**	**1.5**	**10.3**	**19.3**	**30.1**	**13.1**
이익률(%)												
매출원가율	52.2	56.3	66.8	68.8	74.0	77.4	77.3	78.6	71.7	59.3	56.2	54.3
매출총이익률	47.8	43.7	33.2	31.2	26.0	22.7	22.7	21.4	28.3	40.7	43.8	45.7
판매관리비율	22.2	30.1	38.2	34.7	32.7	33.7	28.7	17.2	16.8	18.5	26.5	27.1
영업이익률	**25.6**	**13.7**	**-4.9**	**-3.5**	**-6.7**	**-11.1**	**-6.0**	**4.2**	**11.5**	**22.2**	**17.3**	**18.6**
세전이익률	**20.1**	**8.7**	**-5.4**	**-2.1**	**-9.6**	**-11.0**	**-6.5**	**3.0**	**12.9**	**22.0**	**42.6**	**18.4**
당기순이익률	**20.4**	**7.9**	**-2.7**	**-0.5**	**-9.1**	**-10.3**	**-6.2**	**1.8**	**11.8**	**19.9**	**37.4**	**15.2**
지배당기순이익률	**20.4**	**7.9**	**-2.7**	**-0.5**	**-9.1**	**-10.3**	**-6.2**	**1.8**	**11.8**	**19.9**	**37.4**	**15.2**

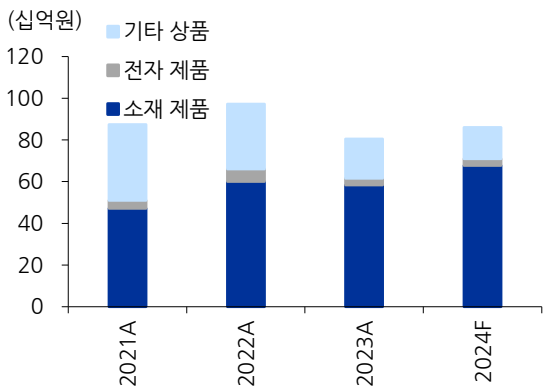
자료: 에이치엔에스하이텍, 유진투자증권

도표 9. **연간 매출액, 영업이익률 추이 및 전망**



자료: 에이치엔에스하이텍, 유진투자증권

도표 10. **연간 제품별 매출 추이 및 전망**



자료: 에이치엔에스하이텍, 유진투자증권

Ⅲ. Valuation

가) 비교기업 적용 PER 배수 산출

도표 11. **2024 년 반기 연환산 기준 비교기업 PER 산출**

(단위: 천원, 원, 주, 배)	에스앤에스텍	덕산네오룩스	피엔에이치테크
적용 당기순이익(A)	31,198,905	37,139,335	4,536,153
적용 주식수(B)	21,451,447	24,831,179	9,935,755
주당 순이익(C=A/B)	1,454	1,496	457
기준주가(D)	26,680	31,398	9,262
PER(E=D/C)	18.34	20.99	20.29
평균 PER 배수	**19.87**		

(주 1) 적용 당기순이익은 2024 년 반기 연환산 기준 (지배주주) 당기순이익을 기재
* 산식 = (2024 년 1 분기 순이익 + 2024 년 2 분기 순이익) x 2 = 2024 년 반기 연환산 기준 순이익
(주 2) 적용주식수는 평가기준일(2024 년 09 월 02 일) 기준 상장주식수
(주 3) 기준주가는 평가기준일(2024 년 09 월 02 일) 기준 Min[20 영업일 평균 종가, 5 영업일 평균 종가]
자료: 증권신고서, 유진투자증권

나) 주당 평가가액 산출

도표 12. **PER 에 의한 에이치엔에스하이텍의 평가가치**

(단위: 원, 주, 배)	산 출 내 역	비 고
적용 당기 순이익	13,082,172 천원	A (주 1)
적용 PER	19.87 배	B
기업가치 평가액	259,942 백만원	C = A * B
적용주식수	8,061,064 주	D (주 2)
주당 평가가액	**32,247 원**	**E = C / D**

(주 1) 동사의 2024 년 반기 당기순이익을 연환산한 금액을 사용하였습니다.
* 산식 : 2024 년 반기 당기순이익 6,541,086 천원 X 2 = 13,082,172 천원..
자료: 증권신고서, 유진투자증권

다) 희망공모가액의 결정

도표 13. **에이치엔에스하이텍(주)의 희망공모가액 산출내역**

구분	내 용	비고
주당 평가가액	32,247 원	-
평가액 대비 할인율	19.37% ~ 31.78%	주 1)
희망공모가액 밴드	22,000 원 ~ 26,000 원	-
확정 주당 공모가액	미정	주 2)

(주 1) 2023 년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
(주 2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
자료: 증권신고서, 유진투자증권

Ⅳ. 회사 소개

글로벌 3 위, 국내 1 위의 ACF 전문 제조업체

도표 14. **기업 개요**

일반현황

회사명	에이치엔에스하이텍㈜ (H&SHighTech Corp.)	설립일	1995.12
대표이사	김 정 희	임직원	172명
사업영역	전자통신부품 제조, 판매 / 반도체 제품 개발, 공급		
재무상태	자산 983억원 | 부채 88억원 | 자본 895억원		
경영실적	매출 804억원 | 영업이익 135억원		
주주구성	최대주주 등 19.0% | 5% 이상 13.3% | 기타 67.7%		
조직구성	2개 사업부 172명		
소재지	- 본사: 대전광역시 유성구 테크노 1로 62-7 - 안산지점: 경기도 안산시 단원구 해안로 73		
홈페이지	www.hnshightech.com		

* 임직원 및 지분구조 등은 증권신고서 제출일 | 경영실적은 '23년 기준

CEO Profile



대표이사 **김 정 희**

- '92~'96 前 삼등산업㈜
- '96~'12 前 케이큐티㈜ 대표이사
- '05~ 現 에이치엔에스하이텍㈜ 대표이사

※ 수상내역
- '99 대한무역협회장상 수상
- '00 석탄산업훈장 수상
- '05 산업자원부 표창장 수상
- '24 금탑산업훈장 수상

주요 경영진

성명	직급	주요 업무	기간
김 진 자	부회장	운영총괄	• ~'93 Loyola Marymount University • '93~'12 前 삼성전자㈜ 무선사업부 전무이사 • '13~현재 現 에이치엔에스하이텍㈜
배 의 호	사장	사업총괄	• ~'07 건국대학교대학원 행정교육 • '87~'09 前 써니전자㈜ 대표이사 • '09~'12 前 케이큐티㈜ 부사장 • '12~현재 에이치엔에스하이텍㈜
박 승 태	부사장	전자총괄	• ~'18 LG그룹 • '19~'22 에이치엔에스파워텍 • '22~현재 에이치엔에스하이텍㈜
장 덕 규	상무이사	ACF 영업	• ~'15 LG전자㈜ • '15~현재 에이치엔에스하이텍㈜

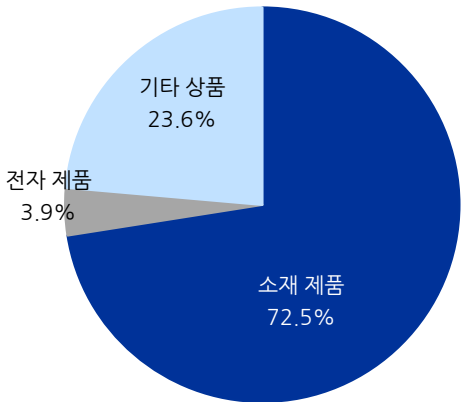
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 15. **주요 연혁**

연도	주요 사업 내용
1995	㈜디에스아이 설립. ACF 연구개발 착수
2000	㈜디에스아이 → 텔레포스㈜ 사명 변경
2009	텔레포스㈜ → 에이치엔에스하이텍㈜ 사명 변경
2012.02	㈜이그잭스 ACF 사업부 인수
2012.12	케이큐브㈜ 흡수합병
2013.12	LG 이노텍㈜) ACF 사업부 인수
2013	첨단기술사업 지정(미래창조과학부)
2015.	한국거래소 코넥스 시장 상장
2015	주파수 제어제품(OSC) 대전 생산 라인 증설
2023	ACF 사업부 안산공장 생산라인 증설 완료
2024.10	코스닥시장 상장 예정(10 월 중순경)

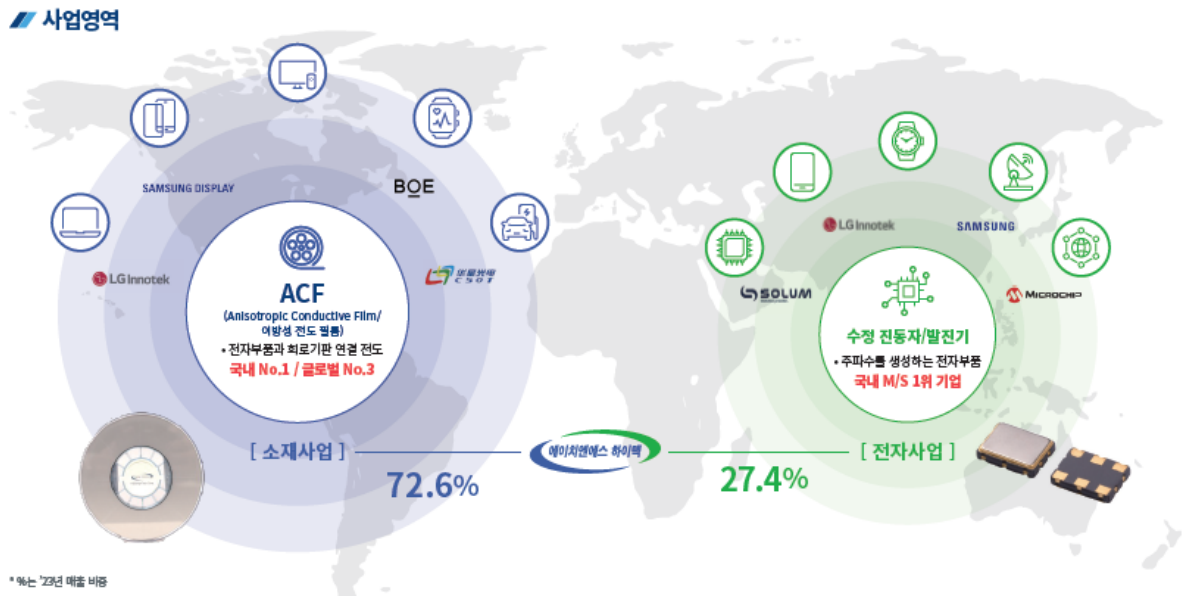
자료: 유진투자증권

도표 16. **사업별 매출 비중 (2023 년 기준)**



자료: 유진투자증권

도표 17. 사업 영역



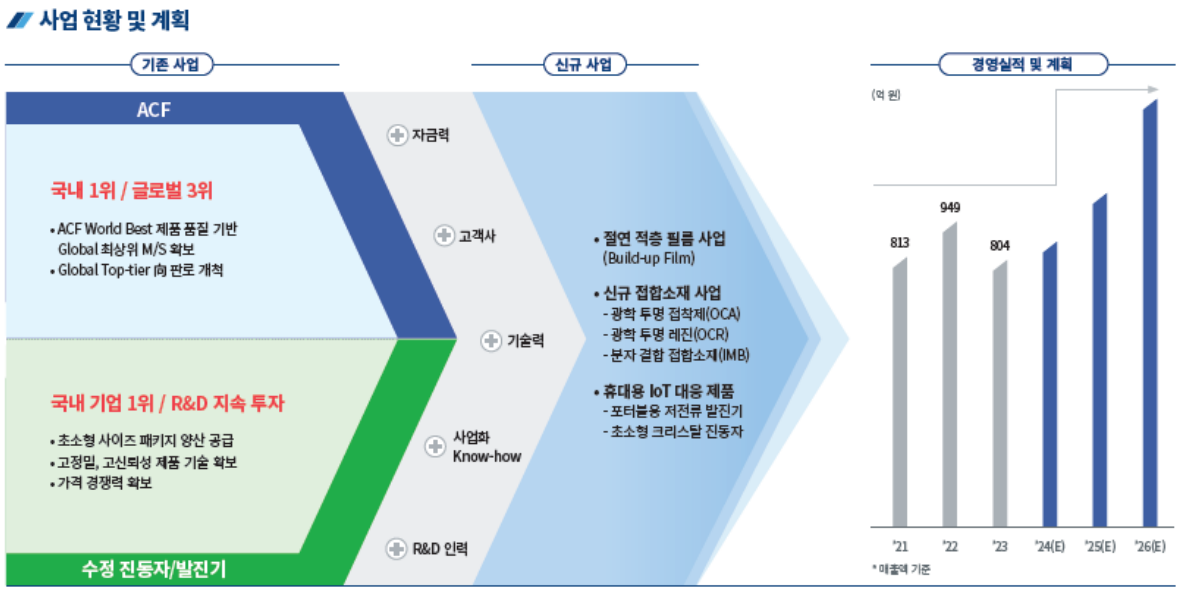
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 18. 성장 연혁



자료: IR Book, 유진투자증권

도표 19. Corporate Identity



자료: IR Book, 유진투자증권

도표 20. 제품 소개

구분	제품명	제품군	적용 제품	제품 설명
소재 사업	ACF (Anisotropic Conductive Film /이방성 전도 필름)	LCD Pannel	TV용	• OLB(Outer Lead Bonding): TV 등 대형Diplay의 LCD패널과 PCB사이의 접합 목적 • PWB(Print Wire Board): 주로 PCB와 PCB간의 접합 목적으로 활용
			Mobile 등 중소형 용	• COG(Chip On Glass): Mobile 등 중소형 Display의 LCD패널(Glass)과 DDI와의 접합 • FOG(Film On Glass): 중소형 Display 모듈의 Panel Glass 와 FPCB간 접합하는 용도로 사용
		OLED Display	Rigid OLED용	• COG: Mobile 등 중소형 Display의 OLED 패널(Glass)과 DDI와의 접합 • FOG: 중소형 Display 모듈의 OLED Panel Glass 와 FPCB간 접합하는 용도로 사용
			Flexible Oled용	• COP(Chip On Plastic): Film Sensor와 DDI와의 접합 • FOP(Flex On Plastic): PI기판과 FPCB간 접합 목적
		Mobile Camera Module	Camera Module용	• CM: 휴대폰 카메라 모듈과 FPCB의 접합 목적
		Touch Panel	Touch Pannel용	• Touch: 터치패널 내 Touch Sensor와 FPCB간 접합 목적으로 감압식/정전식 터치스크린에 활용
		FOF	Film on Filme용	• FOF(Film On Film): 휴대폰 등 전자제품 내 FPCB간의 접합 목적으로 활용되는 제품으로 FPCB와 Digitiz(위치 입력장치) 간의 접합에도 사용
		LED Display	Led Display용	• Micro LED 등 LED 디스플레이 패널에서 LED Chip과 서브스트레이트(Substrate, Wafer)와의 접합 목적으로 사용 • Micro LED 패널 면적 전체에 ACF적층이 필요
전자사업		Crystal Osillator(수정발진기)		• 가장 일반적인 산업용 Clock OSC. 회로에서 일정한 Clock 신호를 발생시켜 동기화 시켜주는 전자 부품 • 국내 경쟁사로는 써니전자, 엑사이엔씨 해외 경쟁사는 Murata, Epson, TXC, CREC, Hosonic등이 있으며, 가격경쟁력이 심한 Type의 Oscillator는 협력사 통해 생산
		Crystal(수정진동자)		• Quartz와 Electrode, Package로 구성된 Frequency 진동소자. 외부 IC와 결합하여 System이 필요로 하는 주파수 발생 • Package종류와 Size별로 다양한 주파수 존재. 고전적인 Type으로 Metal Package 사용, IOT 등의 소형 Application Size에는 Ceramic Package 사용 • Oscillator 보다 저가형으로, 대량양산시 가격적인 장점, 높은 수요

자료: IR Book, 유진투자증권

V. 투자포인트

1) 시장지배력을 기반으로 안정적인 실적 성장 지속 전망

도표 21. "부품 소형화"에 대한 시장 Needs 충족 접합기술은 Fine Pitch 가능한 "ACF"가 유일

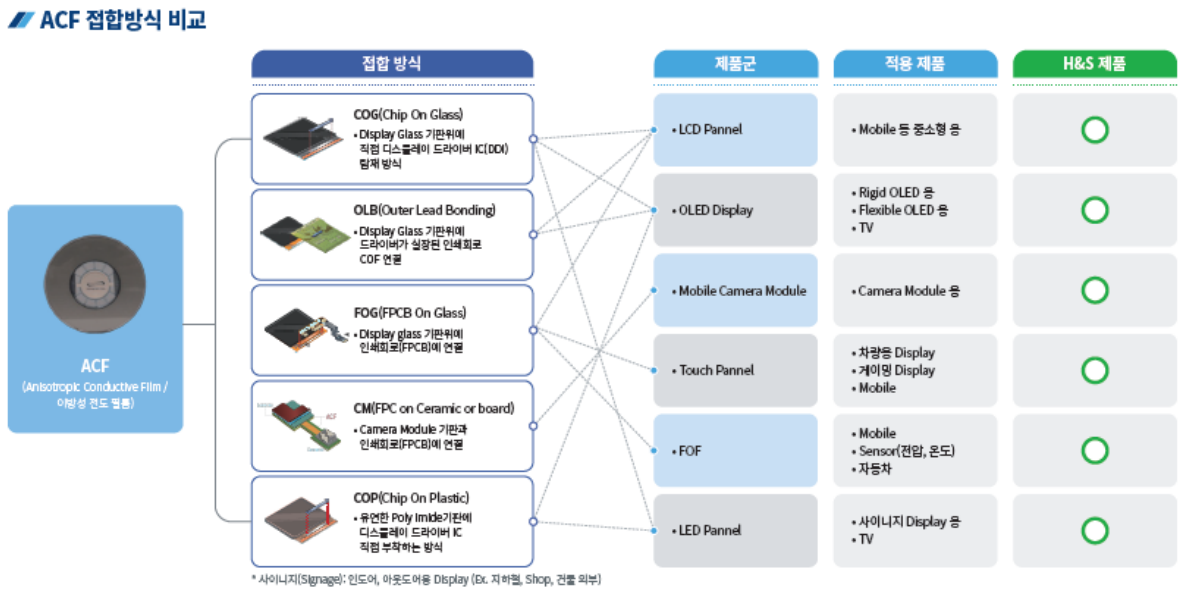


구분	SMT(**)	커넥터	ACF
두께	상	중	최상
전도성	상	중상	상
접착성 (신뢰성)	상	불가능 (기구적 체결 가능)	상
Fine Pitch(*)	불가능	불가능	가능
가격경쟁력	하	중상	상
주 적용제품	범용 전자 제품	파등	고해상도 디스플레이/ 카메라 모듈 Sensor 등
참여 기업(개사)	다수	파등	극소수

* Fine Pitch: 미세 집적회로의 리드(칩셋과 외부 회로 연결 전선) 사이의 미세한 간격
** SMT(Surface Mount Technology): 표면 실장형 부품을 전자회로에 부착시키는 방법

자료: IR Book, 유진투자증권

도표 22. IT 제품 고도화 필수 부품으로 제품 특성에 따른 다양한 접합 방식 적용



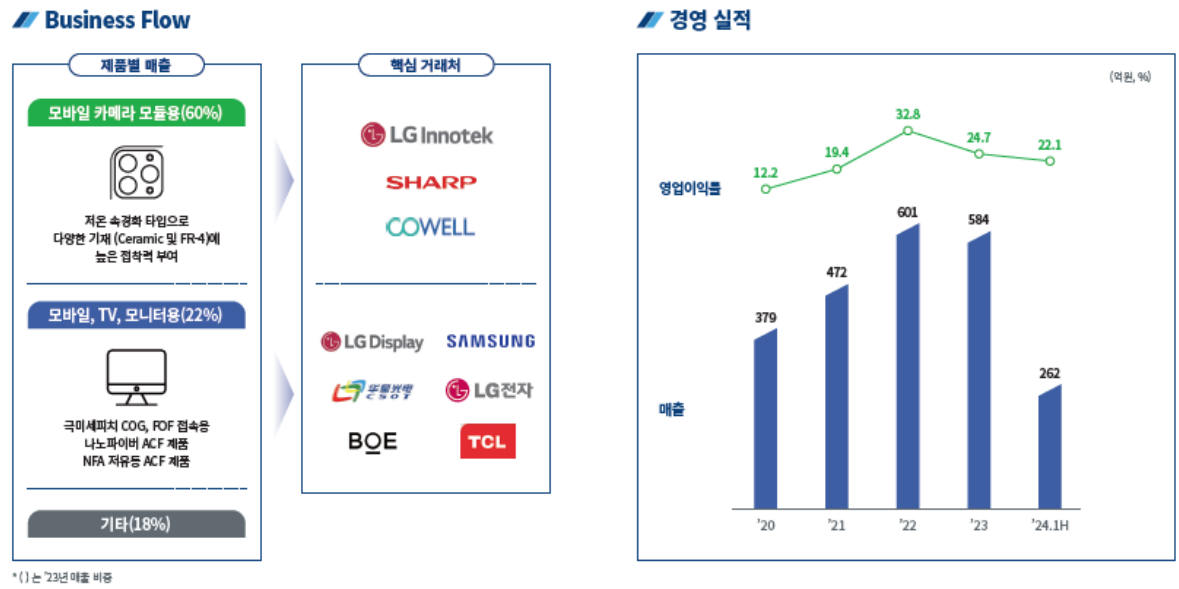
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 23. IT 시장 ACF 채택 비중 증가로 H&S, 절대우위 시장 지위 확보



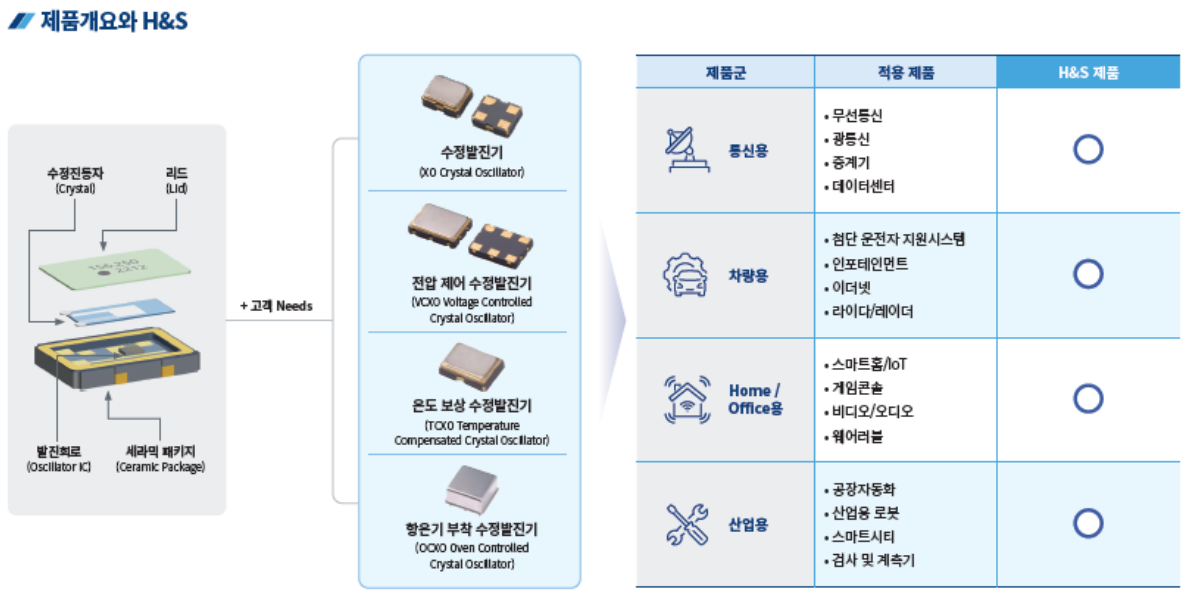
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 24. 입증된 제품경쟁력 기반 안정적 수익구조로 최근 3 개년 20% 초과 OPM 달성



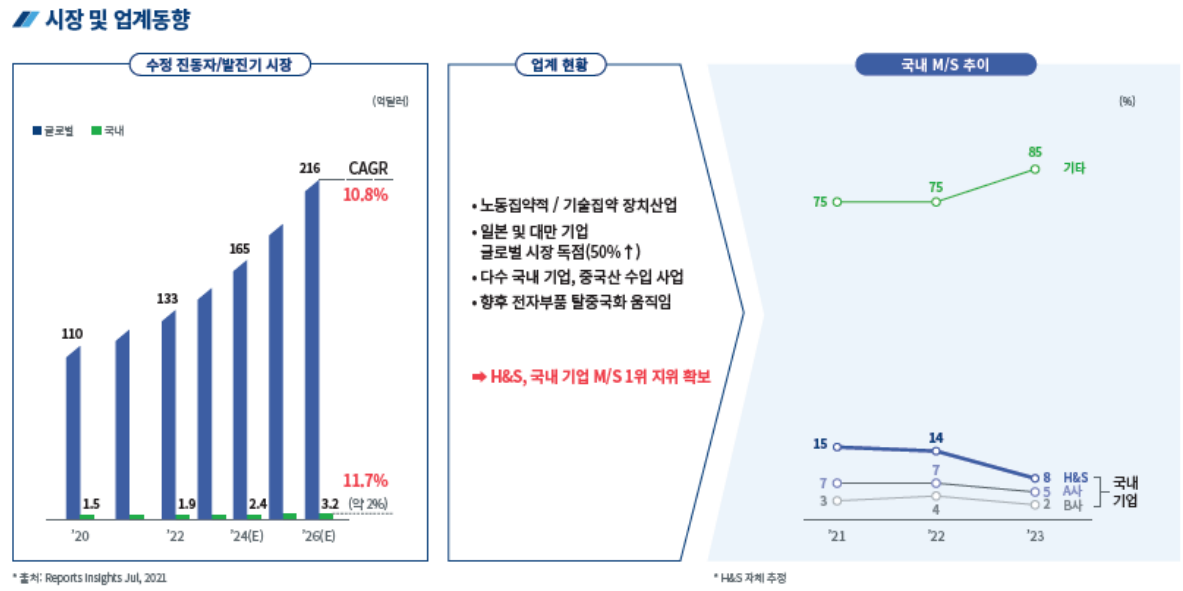
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 25. 전자기기에 정밀한 주파수를 제공하여 정확한 신호와 시간 동기화 … H&S, Full Line-up 구축



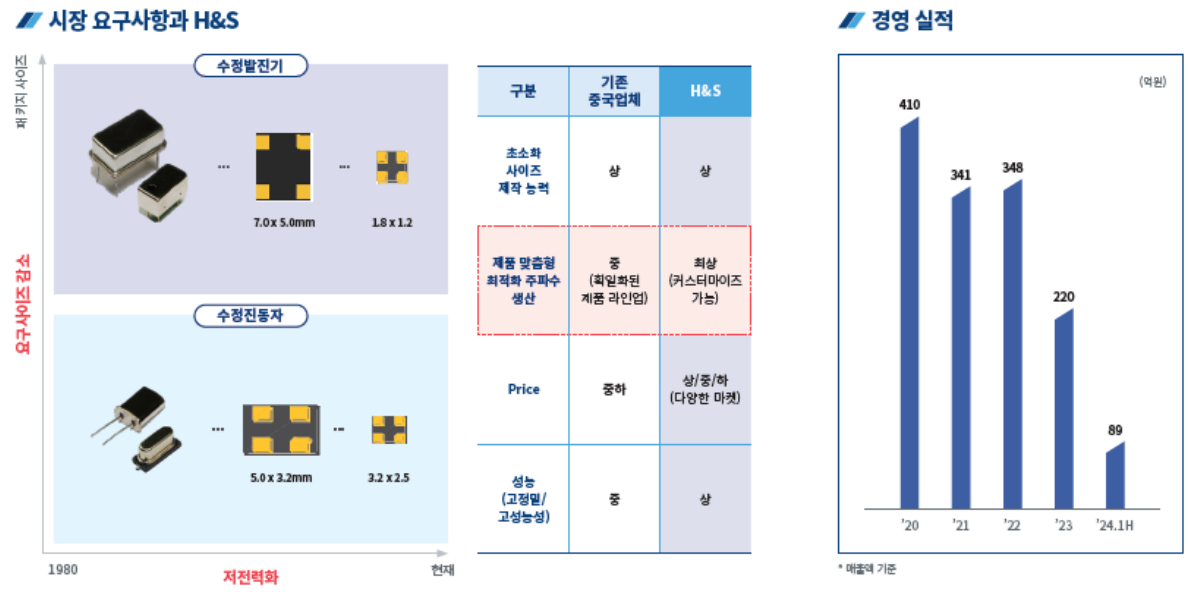
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 26. 적용제품 및 기술력 양극화 진행 중이며 H&S, 국내 기업 M/S 1 위



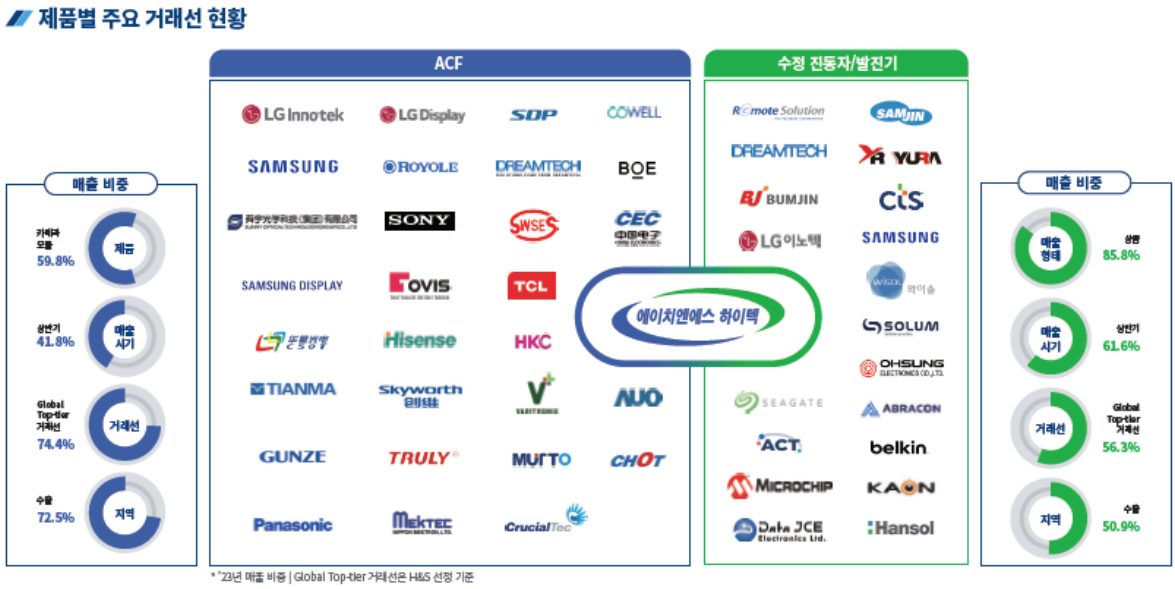
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 27. 시장 Needs 고도화로 시장 이원화 추세이며 H&S, 수익성 제고 사업 전개



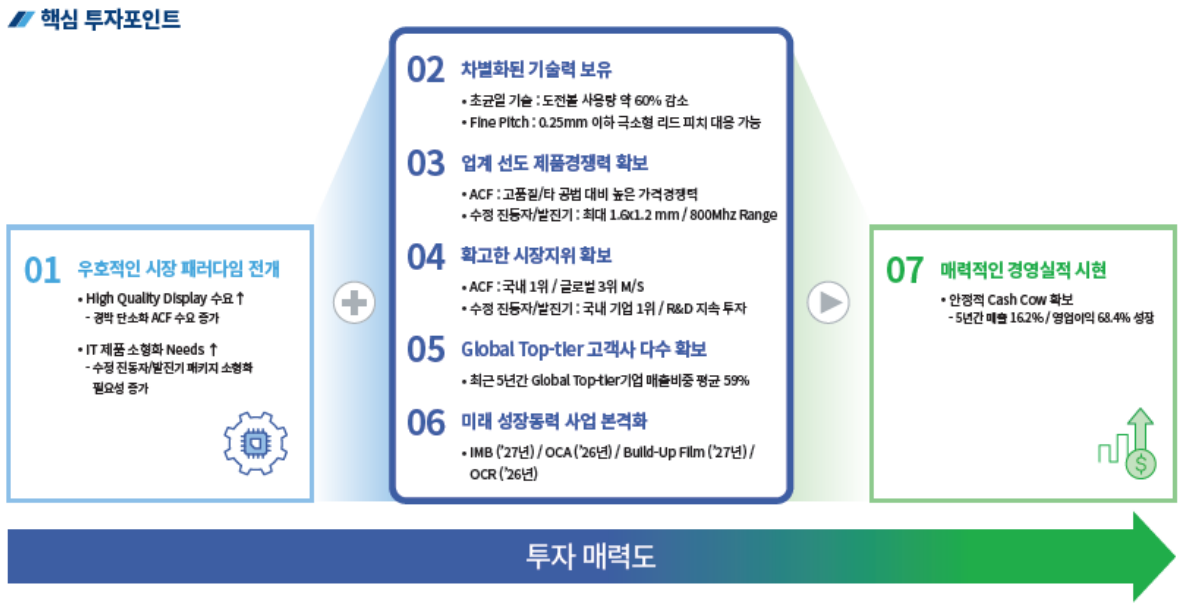
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 28. Global Top-tier 거래선 다수 확보



자료: IR Book, 유진투자증권

도표 29. **확고한 시장지위 기반 미래 성장동력 확보, 최근 5 년간 20% 내외 OPM 달성**



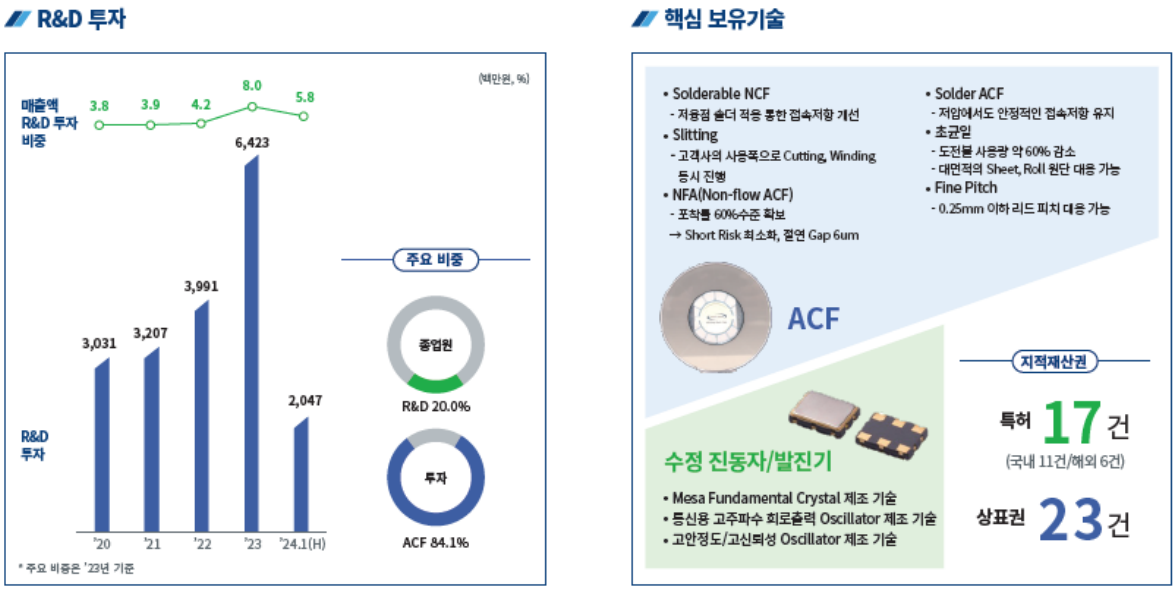
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 30. **고기능 제품 수요 시장 가속화로 업계 선도 기술 및 제품경쟁력 보유한 H&S 수혜**



자료: IR Book, 유진투자증권

도표 31. 시장 Needs 대응 가능 기술력 확보



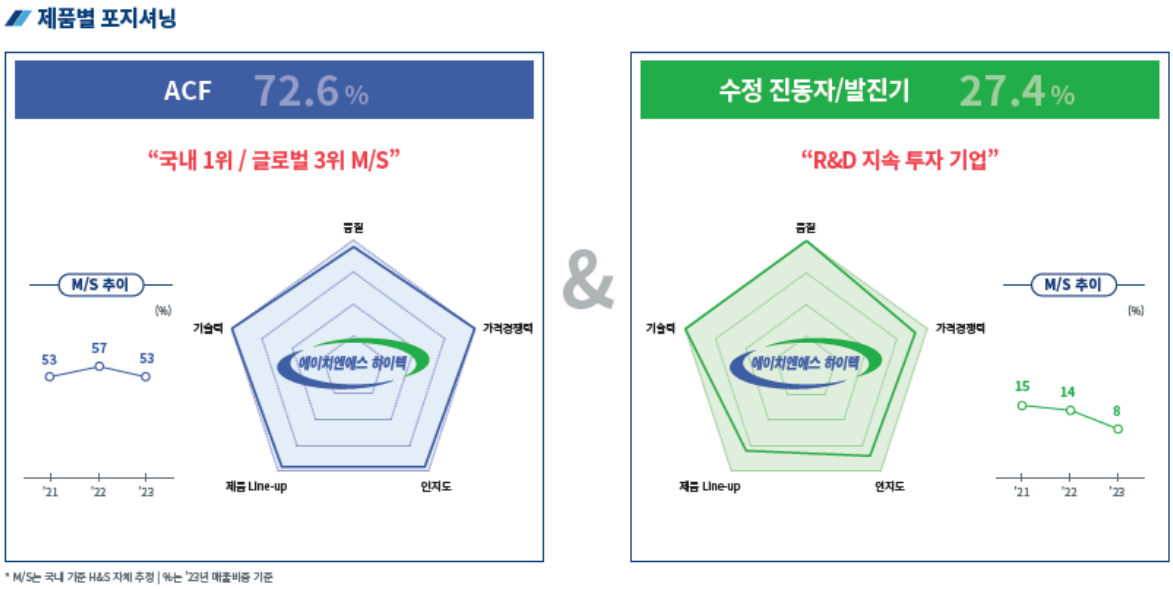
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 32. 차별화된 기술력 기반 글로벌 Top-tier 제품경쟁력 확보



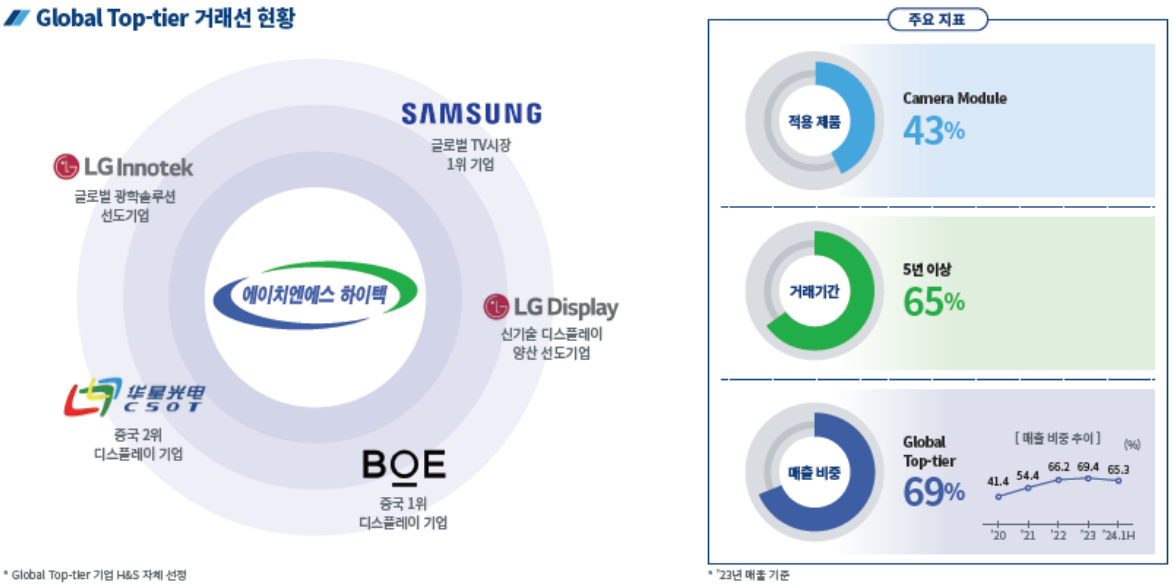
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 33. 차별화된 제품경쟁력 기반 확고한 시장 지위 구축



자료: IR Book, 유진투자증권

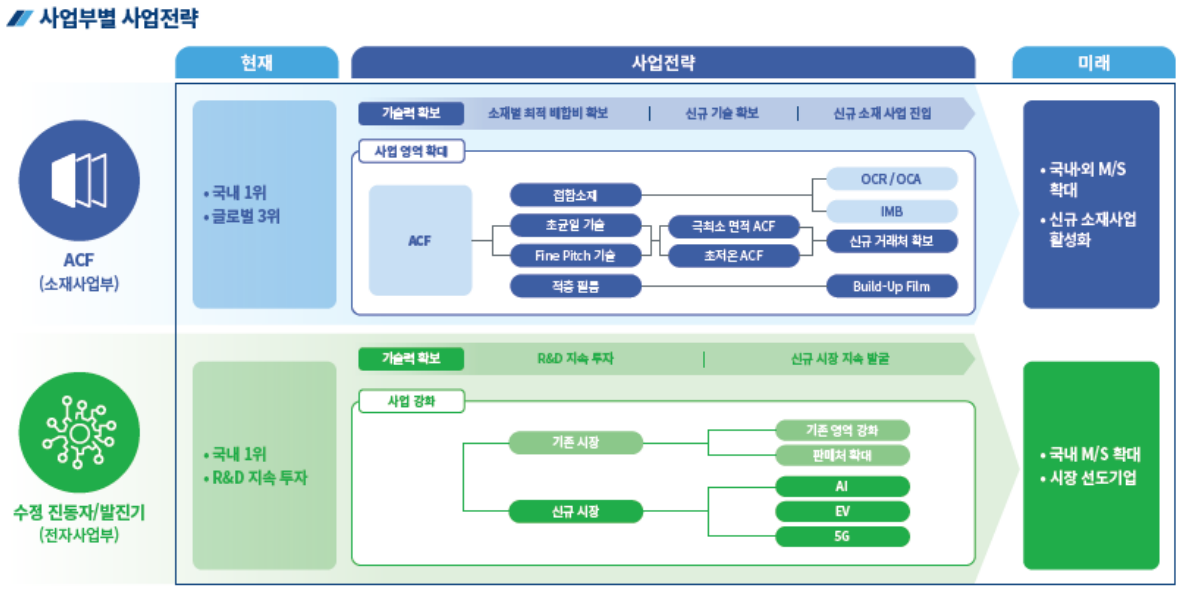
도표 34. Global Top-tier 고객사 확보



자료: IR Book, 유진투자증권

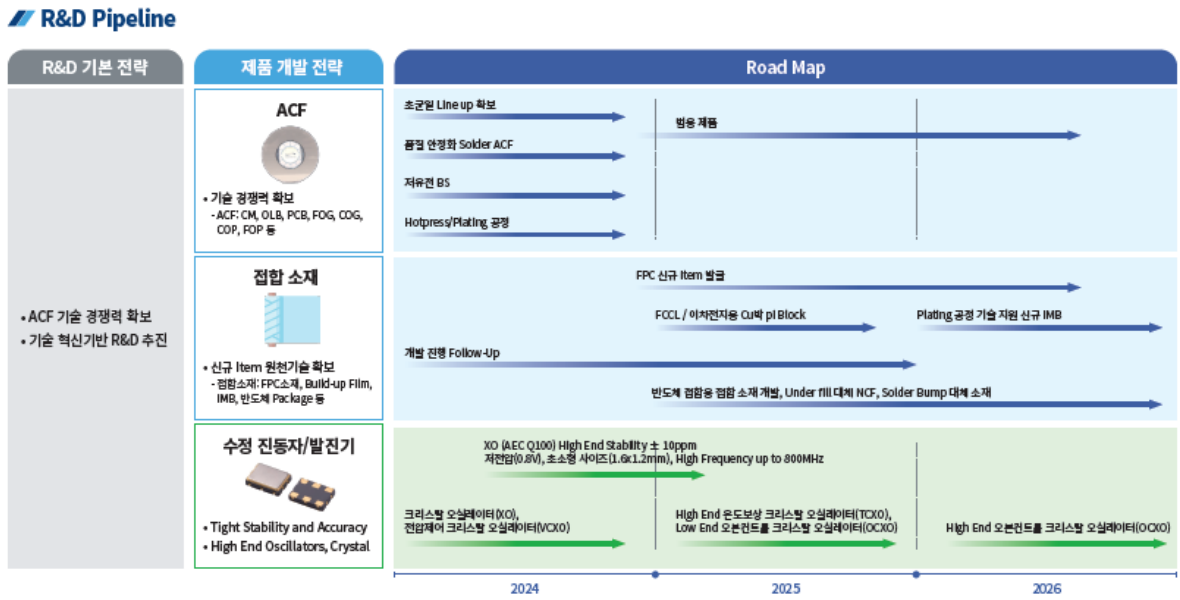
2) 신규 사업을 통한 중장기 실적 성장 기대

도표 35. 글로벌 선도기술력 기반 사업강화 및 사업영역 확대



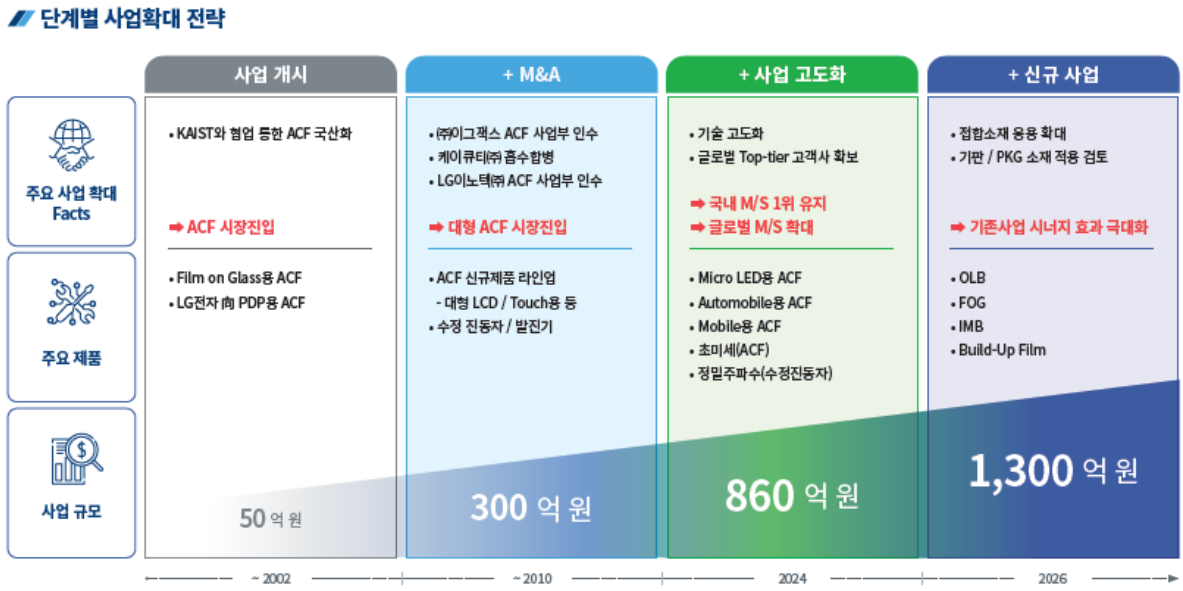
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 36. 제품 기술 고도화 및 신규 제품 원천기술 확보



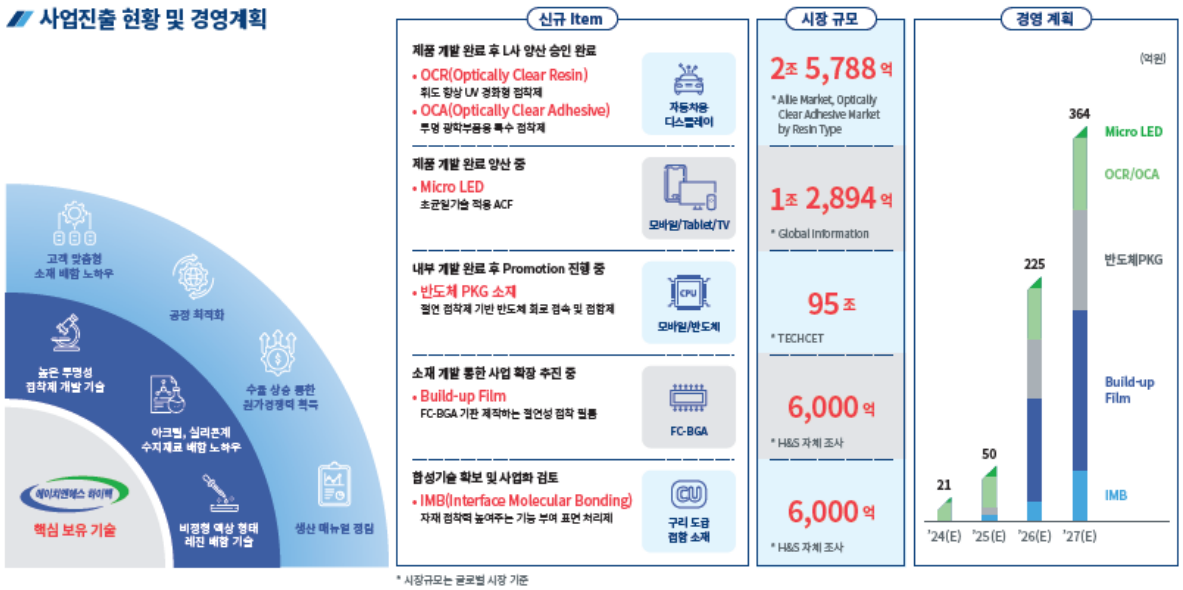
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 37. 사업성과 시너지 효과 기반 사업확대 추진 … ACF > +수정 진동자/발진기 > +접합소재



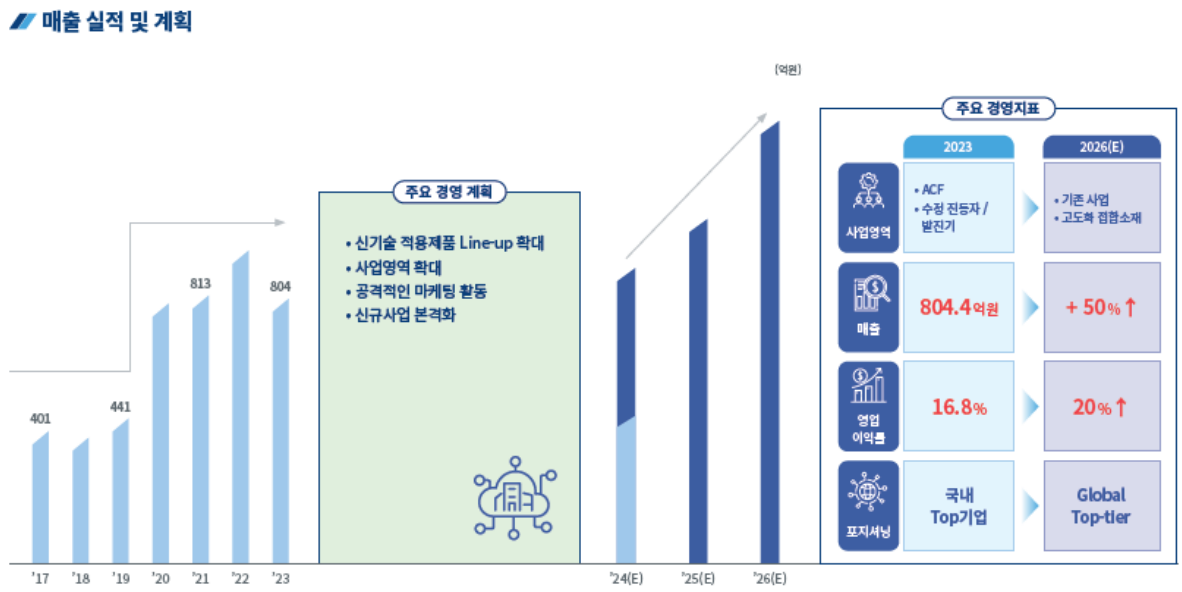
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 38. 시너지 효과 큰 접착소재 사업화 가시권 진입 … 27 년 매출 364 억원 목표



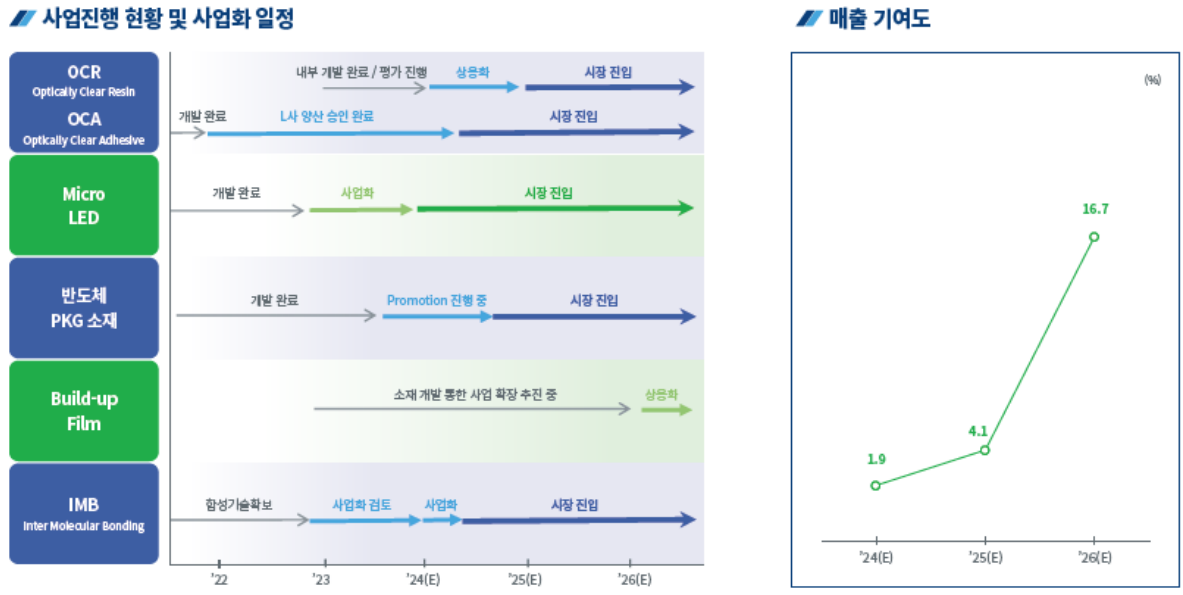
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 39. 시장 트렌드 부합 사업구조 및 신규사업 가시화로 예년 성장률 대비 큰 폭 성장 전망



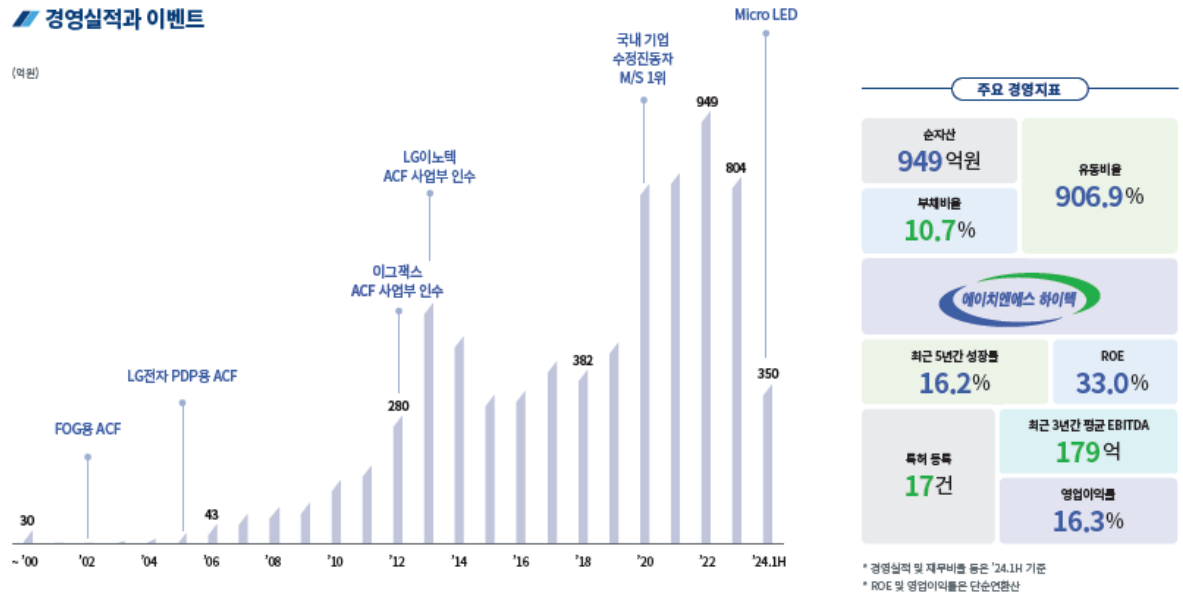
자료: IR Book, 유진투자증권

도표 40. 미래 성장동력 사업 본격화



자료: IR Book, 유진투자증권

도표 41. 30 년간 기술 노하우 축적 기반 우수한 경영지표 달성



자료: IR Book, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	95%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	4%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%

(2024.06.30 기준)